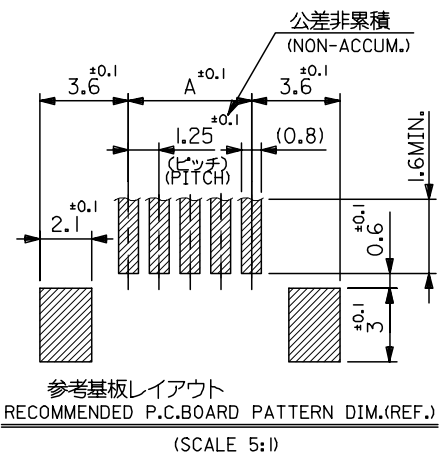
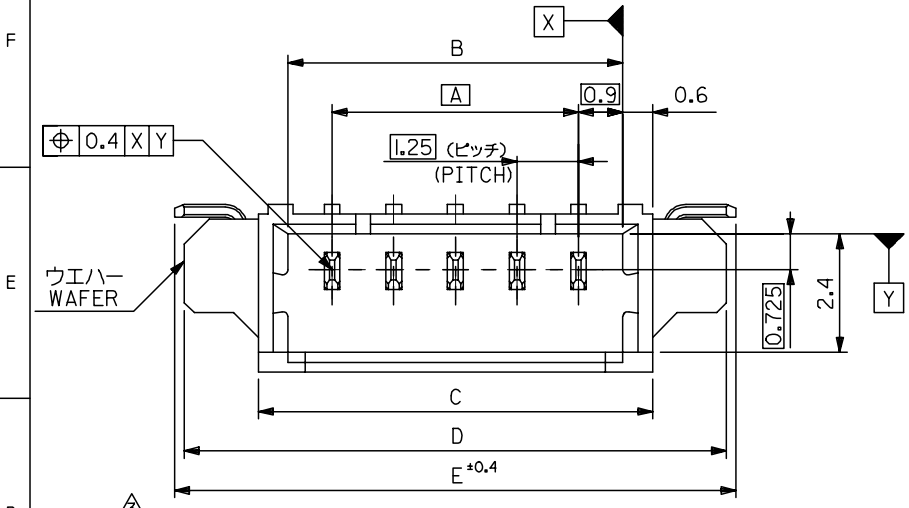
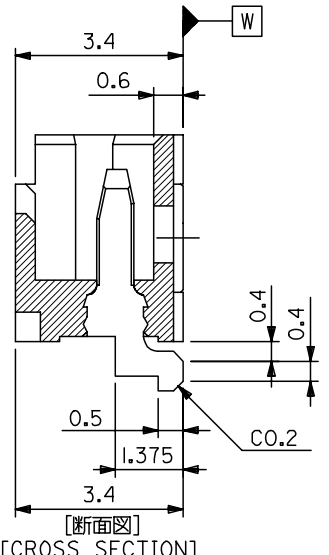
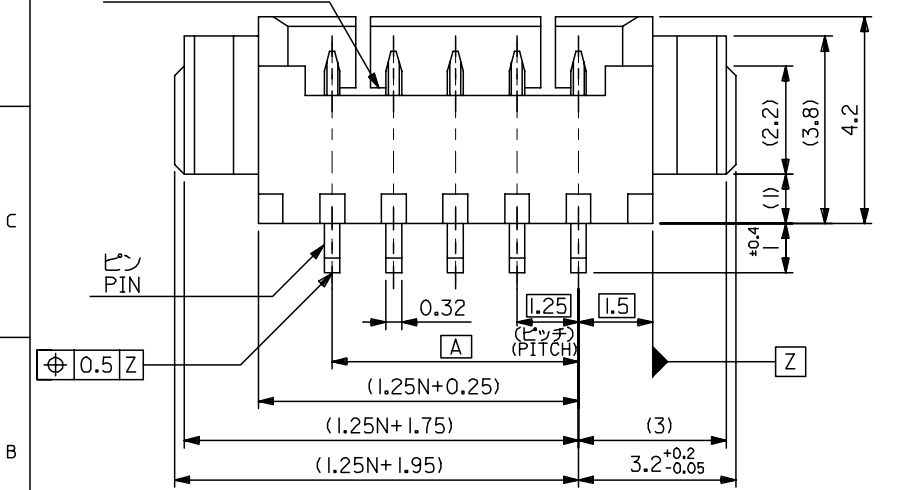


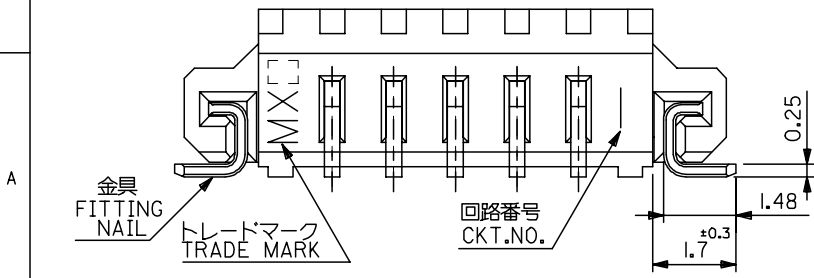
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



- 注記 NOTES**
1. 嵌合相手: 51021 シリズ
MATES WITH: 51021 SERIES
 2. 材質 MATERIAL
ウエハー: NYLON46, UL94V-0
ピン: リン青銅, 半田メッキ
PIN: PHOS-BRO., Sn-Pb(9:1) 3 μmMIN.
OVER Cu 1 μmMIN.
PLATING
金具: リン青銅, 半田メッキ
FITTING NAIL: PHOS-BRO., Sn-Pb(9:1) 2 μmMIN.
OVER Cu 1 μmMIN.
PLATING
 - △ ロック窓は2、3極は1箇所、4極以上は2箇所とする。
LOCKING WINDOW:
ONE PLACE FOR 2 AND 3 CKT. AND
TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.
 4. ソルダテール部のスレ量及び金具(補強板)のスレ量は基準面 W に対し、上方向0.05 MAX.、下方向に0.1 MAX.とする。
OFFSET BETWEEN BASIS PLANE W TO SOLDER TAIL BOTTOM AND FITTING NAIL BOTTOM:
UPPER SIDE: 0.05MAX.
LOWER SIDE: 0.1MAX.

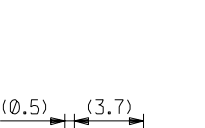
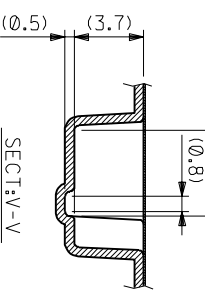
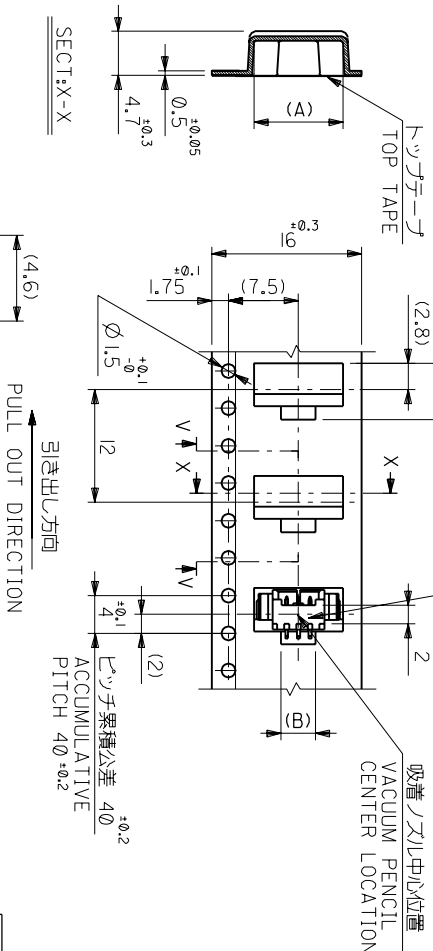
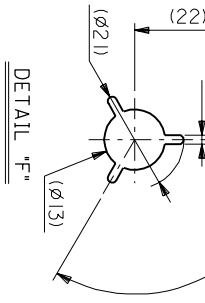
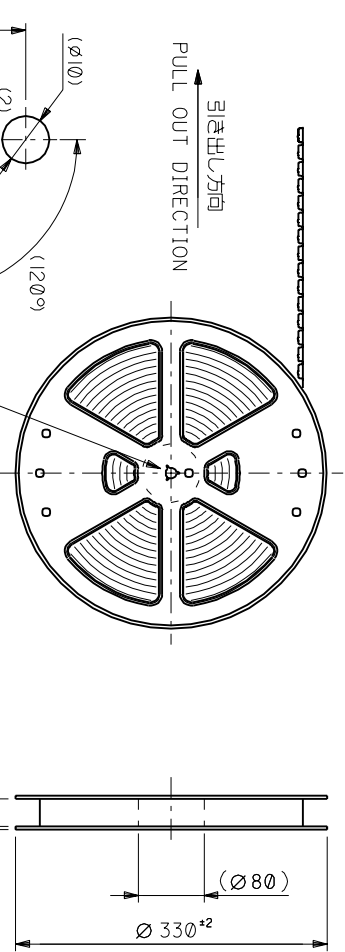


23.9	23.5	20.5	19.3	17.5	53261-1510	15
22.65	22.25	19.25	18.05	16.25	-1410	14
21.4	21	18	16.8	15	-1310	13
20.15	19.75	16.75	15.55	13.75	-1210	12
18.9	18.5	15.5	14.3	12.5	-1110	11
17.65	17.25	14.25	13.05	11.25	-1010	10
16.4	16	13	11.8	10	-0910	9
15.15	14.75	11.75	10.55	8.75	-0810	8
13.9	13.5	10.5	9.3	7.5	-0710	7
12.65	12.25	9.25	8.05	6.25	-0610	6
11.4	11	8	6.8	5	-0510	5
10.15	9.75	6.75	5.55	3.75	-0410	4
8.9	8.5	5.5	4.3	2.5	-0310	3
7.65	7.25	4.25	3.05	1.25	53261-0210	2
E	D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.



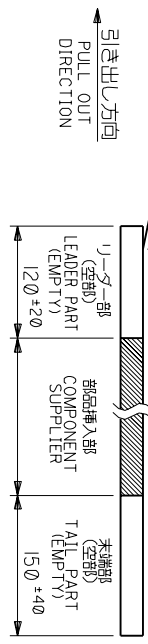
REVISED EC NO: J2005-1631 DRAWN: SUZUKI CHKD: KTOYODA APPR: NUKITA	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
	10 UNDER ±0.2 10 OVER 30 UNDER ±0.25 30 OVER ±0.3	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		DRAWN BY HSEKINE DATE 89/10/18	CHECKED BY HHIRAMOT DATE 94/06/23	TITLE 1.25 WIRE TO BOARD WAFER ASS FOR SMT RIGHT ANGLE		
	APPROVED BY MFUKUSHI DATE 94/06/23		MATERIAL NO. SEE DRAWING		DOCUMENT NO. SD-53261-**10		SHEET NO. 1 OF 1	
	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



注記
NOTES

- 53261-***10の詳細寸法については図面SD-53261-***10を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-53261-***10.
- 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTOR: 1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
トップテープ未接着部 TOP TAPE NON-BONDED PART
トップテープリーダ部 TOP TAPE LEADER PART
175 ±25



4. トップテープの剥離強度: $\phi.1N \sim \phi.59N$ ($10.2 \sim 60gf$) (剥離方向は下図参照)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: $\phi.1N \sim \phi.59N$ ($10.2 \sim 60gf$)
(PEELING DIRECTION IS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

<剥離速度: 300mm/min (参考)>
PEELING SPEED: 300mm/min (REFERENCE)

剥離方向 PEEL OFF DIRECTION
引き出し方向 PULL OUT DIRECTION

5. 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ(CARRIER TAPE): ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材含む>
POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

△ コネクタ、ハウジング平面部
CONNECTOR, HOUSING FLAT AREA

角度 ANGLE	±3°
30分片	±0.3
10分片	±0.25
10分片	±0.2
10分片	±0.2

REVISED	02001-0431	S.M.	1.1	00/12/8
REVISION RECORD	REVISED	02001-0431	S.M.	1.1
REVISION RECORD	REVISED	02001-0431	S.M.	1.1
REVISION RECORD	REVISED	02001-0431	S.M.	1.1

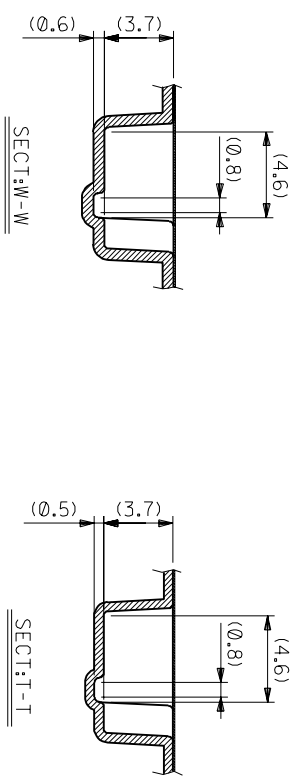
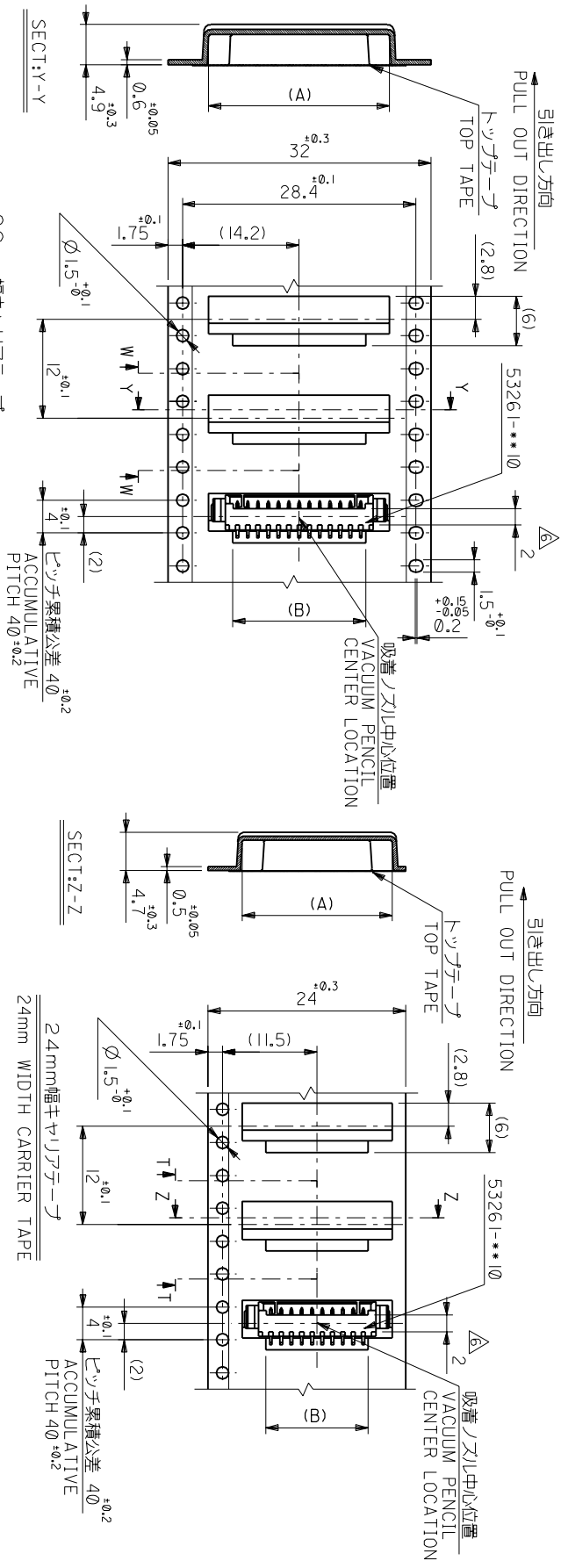
材料	キャリアテープ	16	3.7	9.5	53261-03390	3
キャリアテープ幅	C	B	A	ENG. NO.	極数	CKT.
仕上げ	---	---	---	---	---	---
適用電線範囲	---	---	---	---	---	---
被覆外径	---	---	---	---	---	---
NS. RANGE	---	---	---	---	---	---
DRAWN BY	93/6/1	CHK'D BY	00/12/8	---	---	---
APP'D BY	00/12/8	---	---	---	---	---
K.T.OJO	---	---	---	---	---	---
M.FUKUSHIMA	---	---	---	---	---	---
DATE	---	---	---	---	---	---

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	---
TITLE 名称	---
1.25 WIRE TO BOARD CONN.	---
WAFER ASS'Y FOR SMT	---
EMBOSSSED TAPE PACKAGE	---
DWG. NO.	SD-53261-***90
SHEET 1 OF 3	REV

8 7 6 5 4 3 2 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モリス(株)の所有する情報を含むものな。当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C033MXJ-32



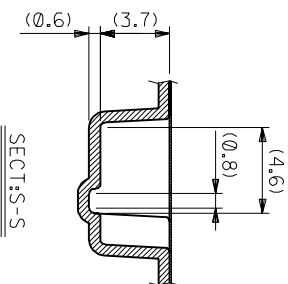
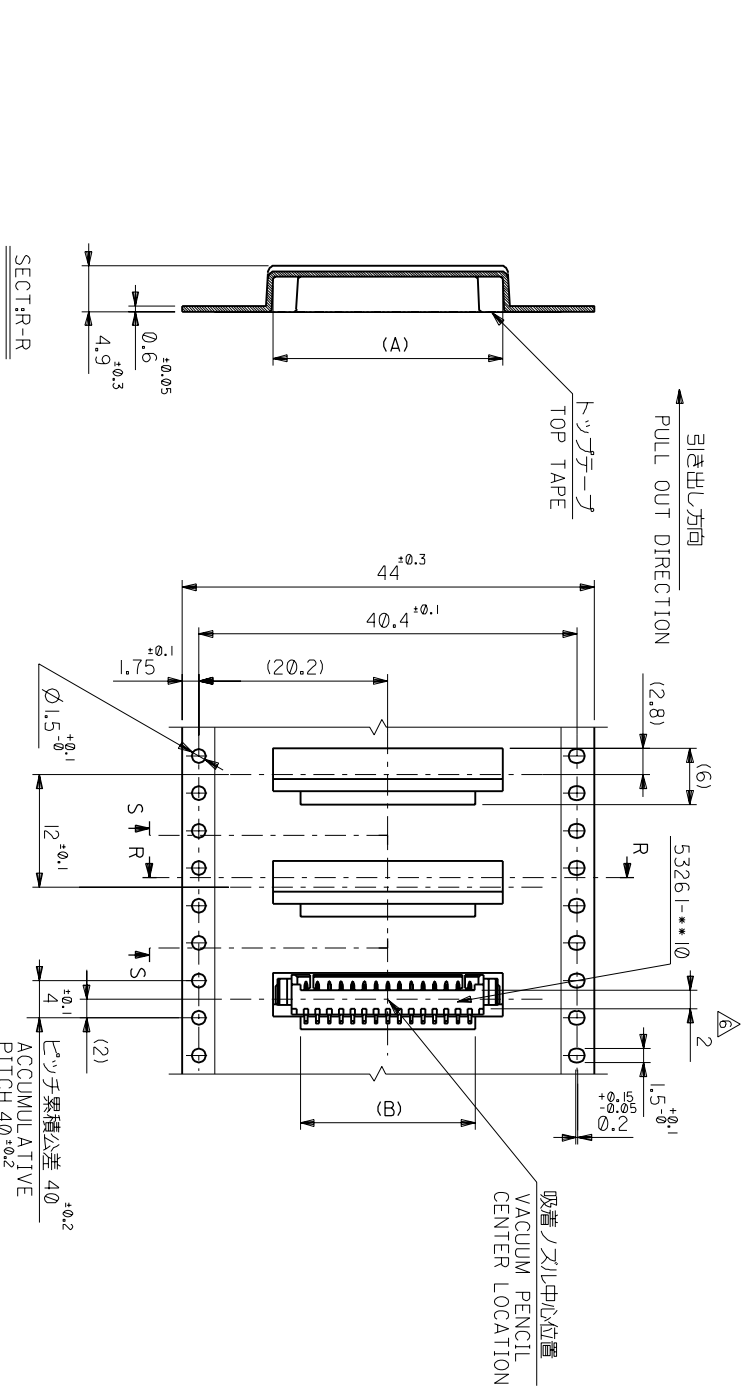
角度	ANGLE	±3°
30分	未注	±0.3
10分	未注	±0.25
10分	未注	±0.2
10分	未注	±0.2

REVISED	訂正	DATE	BY
REVISION RECORD	訂正内容	日付	氏名
DR. CHK. DATE	検査内容	日付	氏名

FINISH	仕上げ	—
適用電線範囲	適用電線範囲	—
被覆外径	被覆外径	—
INS. RANGE	被覆外径	—
DRAWN BY	検査内容	DATE
APP'D BY	検査内容	DATE
CHK. DATE	検査内容	DATE

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	モジュール名	モジュール名
1.25 WIRE TO BOARD CONN.	モジュール名	モジュール名
WAFER ASS'Y FOR SMT	モジュール名	モジュール名
EMBOSSED TAPE PACKAGE	モジュール名	モジュール名
DWG. NO.	モジュール名	モジュール名
SHEET 2 OF 3	モジュール名	モジュール名
REV	モジュール名	モジュール名

キャリアテープ幅	キャリアテープ幅	キャリアテープ幅	キャリアテープ幅	キャリアテープ幅	キャリアテープ幅	キャリアテープ幅	キャリアテープ幅	キャリアテープ幅	キャリアテープ幅		
32	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4		
16.2	22	53261-1390	13	14.95	20.75	-1290	12	13.7	19.5	-1190	11
12.45	18.25	-1090	10	11.2	17	-0990	9	9.95	15.75	-0890	8
8.7	14.5	-0790	7	7.45	13.25	-0690	6	6.2	12	-0590	5
4.95	10.75	53261-0490	4								



SECT:R-R

44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

角度	ANGLE	°30
30°以上	未注	±0.3
10°以下	30°未満	±0.25
10°未満	未注	±0.2
一般公差		
記号	REVISION RECORD	記号

記号	REVISION RECORD	記号
記号	REVISION RECORD	記号
記号	REVISION RECORD	記号
記号	REVISION RECORD	記号
記号	REVISION RECORD	記号
記号	REVISION RECORD	記号
記号	REVISION RECORD	記号

材料	MATERIAL	注記参照
仕上げ	FINISH	SEE NOTES
適用電線範囲	WIRE RANGE	---
被覆外径	INS. RANGE	---
AP'D BY	CHK'D BY	
M.FUKUSHIMA	T.YAMAGUCHI	
DATE	SCALE	

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	Molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
TITLE 名称	1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y FOR SMT EMBOSSED TAPE PACKAGE
DWG. NO.	SD-53261-***90
SHEET 3 OF 3	REV F

4 1519325

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもの。当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C032MXJ-32